

NEWS RELEASE

12インチウエハー対応 IC/LSI用ダイボンダーの新機種を販売 高生産性と品質安定性を両立し、従来機種と比較して生産性10%向上を実現

キヤノンマシナリーは、BESTEMシリーズダイボンダーの新機種“BESTEM-D610”の販売を、2025年1月より開始します。



BESTEM-D610は、12インチウエハー対応 IC/LSI（大規模集積回路）用のダイボンダーです。対象チップサイズを従来機種（BESTEM-D510）の8mmまでから15mmまでと拡大したこと、従来の個別オプション機能を標準搭載したことで、幅広いニーズに応えます。新たに開発したボンディングヘッドおよびディスペンユニットの搭載によりパフォーマンスを改善したことで、顧客の生産性と製品品質の向上に貢献します。また、操作画面やデータ表示機能などUIを刷新し、より直感的な操作が可能となりました。

■ 生産性向上

- ・1時間当たりのボンディング回数（UPH）を10%向上。
- ・稼働中に生じる様々な変化に対応する補正機能により、連続稼働時間を3倍に延伸。
- ・上記2点の改善により、従来機種と比較して、24時間当たりの生産性を最大35%向上（当社条件による）。

■ 製品品質向上

- ・ボンディング精度は、従来機種の25 μ mから20 μ mへ改善。
- ・稼働中に生じる様々な変化に対応する補正機能により、長時間の連続稼働中の精度維持を実現。
- ・新たに開発した高剛性なディスペンユニットにより、高精度なペースト塗布が可能。

■ ユーザビリティ刷新

- ・ウィザード機能の改善により、ボンディング位置補正、プリフォーム調整、品種切り替えの容易化。
- ・データ表示機能の充実により、稼働状況の把握が可能。

■ 省エネルギー

- ・従来機種と比較して、1つのチップをボンディングするために必要なエネルギーを最大18%削減（当社条件による）。

〈お問合せ先〉

FAソリューション事業本部 営業部 E-mail : cmi-sales-ml@mail.canon